

Valor NPI

新产品导入（NPI）平台的PCB设计到制造的切换

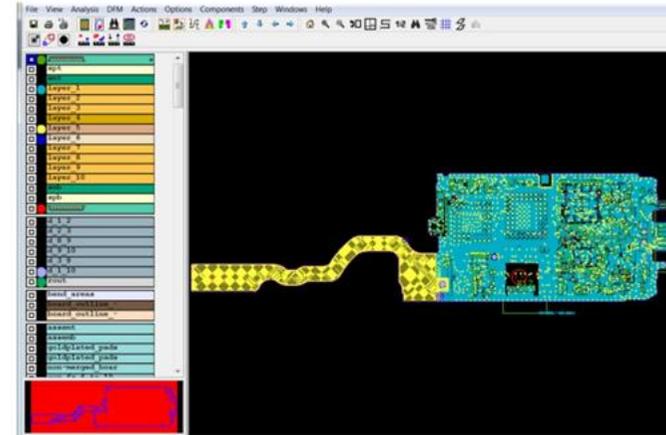
简介

Valor NPI保证了从PCB设计到制造和到组装及测试的平滑过渡。Valor NPI平台提供了全面的DFM分析，并行应用与设计流程的最大优势，或在设计完成。通过结合Valor NPI制造数据创建工具和DFM，产品模型的制造水平可以得到充分的准备，移交工程准备。

对于**PCB设计**，在设计过程中Valor NPI提供了并行的DFM分析，将几乎700制造规则保证设计能在最少返工校订版本生产。DFM分析流程可设置为自动分析每个新版本，并直接查明在CAD系统中的所有潜在的制造问题。

对于**制造NPI工程师**，Valor NPI提供了全面的分析，以证明新产品相匹配的制造工艺。BOM，AVL和元件分析，确保设计符合装配和测试流程。快速反馈给PCB设计允许DFM修正或改进切换到在工程准备之前。充分利用了ODB ++智能数据格式进行优化设计，制造，装配和测试之间的数据交换。

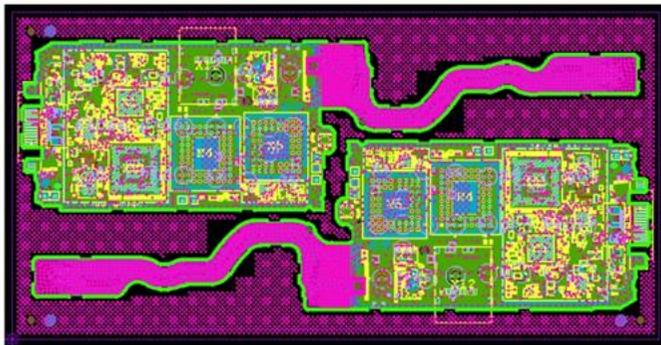
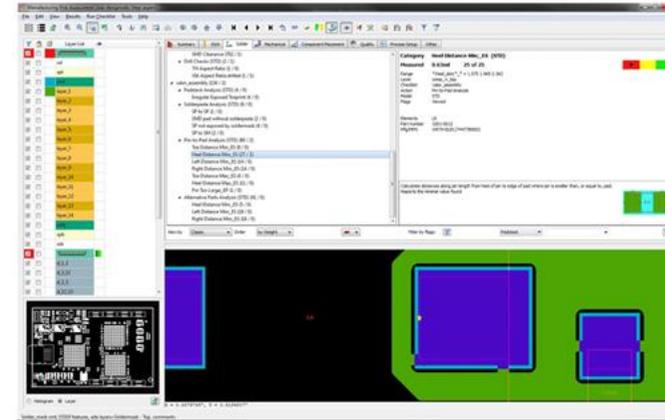
制造，装配和测试完整的DFM分析
同时验证生产上的限制与设计流程。图1



Valor DFF嵌入Xpedition Layout工具
轻松查找和解决在源头的基本制造DFF问题。图2

制造风险评估

标识直接制造违规以及潜在的低产量或现场故障。
图3



完整的，集成的产品数据准备

单个结构化数据包省去了附图和侧文件。图4

Valor Process Preparation

The Valor Process Preparation模块是的DFx，工艺开发和测试的PCB装配操作的完整工程解决方案。使用如优化前端DFA分析，BOM验证，模板设计，SMT编程和线平衡等的工具以改善PCB装配的效率和质量。

简介

简化工程任务使用优化的生产数据

Process Preparation (原名vPlan)提供包括的DFx，SMT，装配和测试技术的PCB装配操作的完整软件解决方案。

随着一个单一的中央数据库基于导入工程输出的ODB ++, 原生CAD及完全可配置的制造流程定义的BOM文件, Valor Process Preparation确保自动化，无差错的设置和输出，PCB组装，测试和检验，一次成功，只需一半的正常时间

数据准备

数据准备子模块支持一系列广泛的CAD和CAM数据格式创建PCA的数据。特点：支持复杂的BOM文件，中央与主供应商零件库（VPL），测试和检验过程，常见的产品数据模型和一个高度简化的，可重复的工作流程。图5



DFA分析

DFA分析由一组制造为重点的检查,这涵盖单PCB和PCB面板的外部制造和装配分析。图6

SMT Multi-vendor编程及元件数据管理

SMT编程子模块是所有支持的机型，其中包括一个完整的SMT编程解决方案：元件数据模型，虚拟胶带，离线编程仿真，自动生成选项和多供应商SMT生产线。

图7



手工组装指导文档，测试和检测

文档子模块将为装配流程明确的工作指示。它消除了生产过程中的误差通过同步每个SMT，THT和手工装配工艺其相应的工作指令，并自动更新。文件可以是只读的PDF套输出，或通过Valor文档查看器查看的交互式文档。图8

钢网设计

钢网设计子模块可优化钢网设计，减少错误，缩短了制造商和钢网供应商的审查周期。

它采用相同的公共数据集作为其他Valor流程，确保一个精简，无差错的工作流程。除了创建钢网，它也将节省设计ODB ++或RS-274X Gerber文件。图9



检验程序

使用检验程序子模块创建机器特定的自动光学检测（AOI）和支持的平台上的自动光学X射线检测（AXI）输出文件。

它优化了产品数据模型和MPL在DFx分析过程中，支持的测试和检验程序。图10

测试编程

创建机器特定的ICT和FPT输出文件支持的平台包括物理设计测试（DFT）分析。

可选的固定复用功能自动执行在PCB上的新版本测试数据中分析，确定哪些测试探针可以被改变。图11

